

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

广东汇成真空科技股份有限公司

Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd.

（广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号）



2026年度向特定对象发行A股股票预案

二〇二六年八月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次发行股票方案尚需经公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。在取得中国证监会注册批复后，公司将依法向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。

2、公司本次发行的发行对象不超过 35 名（含本数），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所相关规定协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

本次所有发行对象均以人民币现金方式、以同一价格认购本次发行的股票。

3、本次发行股票采取询价发行方式，定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。

本次发行的最终发行价格将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证

监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 3,000 万股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册的决定后，由公司董事会根据股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或因股权激励、股权回购注销等事项导致公司股本发生变化，则本次向特定对象发行的发行数量上限将作相应调整。

5、本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 95,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目	76,485.30	66,861.68
2	补充流动资金	28,638.32	28,638.32
合计		105,123.61	95,500.00

本次募集资金到位前，公司可根据募投项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次募投项目建成后，将形成超精密光学镀膜设备、TGV 微孔镀膜设备及连续式镀膜设备等 PVD 设备的自主生产能力，强化公司对全流程工艺环节的精准管控与体系化保障，推动国产 PVD 设备在半导体、消费电子、汽车、新能源等重点产业的关键应用，以更好地满足下游市场持续增长的需求，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

6、本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个

月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深交所的相关规定执行。

7、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施。具体内容详见本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报分析、采取措施及相关主体承诺”。相关分析并非公司的盈利预测，填补回报措施亦不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。

8、公司一贯重视对投资者的持续回报，本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东分红回报计划等具体内容参见本预案“第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况”。

9、本次发行的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化。

10、本次发行前，公司前次募集资金为IPO募集资金，募集资金净额为24,172.70万元，截至2026年6月30日，公司前次募集资金累计使用金额为19,545.99万元，累计使用进度为80.86%。公司前次募投项目中“研发生产基地项目”已达到预定可使用状态，“真空镀膜研发中心项目”正在实施过程中，下一步，发行人将在合法合规前提下，按照战略发展规划和募集资金项目使用计划有序使用剩余募集资金。

11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行

对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行的相关风险说明”，注意投资风险。

目 录

公司声明	2
特别提示	3
目 录	7
释 义	9
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	11
一、发行人基本情况	11
二、本次发行的背景和目的	11
三、发行对象及其与公司的关系	17
四、本次发行方案概述	18
五、本次发行是否构成关联交易	21
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	21
七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	21
八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	21
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	23
一、本次募集资金使用计划	23
二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析	23
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	32
四、本次募集资金使用的可行性结论	32
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	33
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	33
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	34
三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	35
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形	35
五、本次发行对公司负债情况的影响	35
六、本次发行的相关风险说明	35

第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	39
一、公司现行利润分配政策的相关规定	39
二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	42
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划	43
第五节 本次发行摊薄即期回报分析、采取措施及相关主体承诺	44
一、本次发行摊薄及其回报对公司主要财务指标的影响	44
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	45
三、本次发行募集资金的必要性和合理性	46
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	47
五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	47
六、公司相关主体关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺	49

释 义

本预案中，除非另有说明，下列简称和术语具有以下所规定的含义：

汇成真空、发行人、公司、本公司、上市公司	指	广东汇成真空科技股份有限公司
本预案	指	广东汇成真空科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	广东汇成真空科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的行为
股东会	指	广东汇成真空科技股份有限公司股东会
董事会	指	广东汇成真空科技股份有限公司董事会
德国莱宝	指	德国莱宝公司（Leybold），系全球领先的真空技术解决方案提供商
ASML	指	荷兰阿斯麦公司（ASML Holding N.V.），一家半导体光刻设备供应商
天弘科技	指	天弘(东莞)科技有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A股	指	境内上市的人民币普通股股票
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《广东汇成真空科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元（除特别说明外）
真空镀膜	指	在真空环境下，通过物理或化学手段，将金属、非金属或化合物材料转换成气态或等离子态，使其沉积于玻璃、金属、陶瓷、塑料或有机材料等固体材质表面形成薄膜的过程，PVD系真空镀膜工艺其中一种技术路径
PVD	指	物理气相沉积（Physical Vapor Deposition），通过物理手段将固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子（等离子体），在真空空间输运到基体表面并沉积成薄膜的方法，PVD镀膜技术主要分为三类，真空蒸发镀膜、真空磁控溅射镀膜和真空离子镀膜
靶材、溅射靶	指	磁控溅射镀膜中，用高能离子束轰击的材料，是制备薄膜材料的原材料
蒸发源	指	真空蒸发镀膜中，被加热蒸发的物质，是制备薄膜材料的原材料
基材	指	被镀膜覆盖的目标材料

光刻设备	指	是一种投影曝光系统，由光源、照明系统、物镜、工件台等部件组成，主要用于芯片制作中的光刻过程
光刻掩膜版	指	又称光学掩膜版、掩膜版，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，用于下游电子元器件行业批量复制生产
三维堆叠封装	指	一种先进封装工艺，通过在基板内部制造垂直通孔来实现多个芯片堆叠，减少封装体积，提高内部信号传输速度
TSV	指	硅通孔技术，系三维堆叠封装中使用硅基板的技术工艺
TGV	指	玻璃通孔技术，系使用玻璃基板进行三维堆叠封装
nm	指	纳米，长度计量单位，为1米的十亿分之一长

注1：本预案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注2：本预案若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称	广东汇成真空科技股份有限公司
英文名称	Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd.
成立时间	有限公司：2006年8月14日 股份公司：2019年7月26日
上市时间	2024年6月5日
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	汇成真空
股票代码	301392.SZ
法定代表人	李志荣
注册地址	广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号
办公地址	广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路2号
注册资本	10,000.00万元
统一社会信用代码	91441900791240616U
董事会秘书	肖献伟
电话	0769-85635968
传真	0769-85635958
公司网址	www.hcvac.com
经营范围	研发、设计、产销：真空设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备、光伏设备、动力电池设备及产品相关的配件；上述设备、产品的相关制造工艺和应用技术、控制软件、工艺流程控制软件及相关生产自动化软件的研发、应用、技术转让、技术咨询、技术服务；实业投资及股权投资；国内商业贸易（不含国家专营专控商品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、半导体行业高速发展叠加国家政策支持，产业链本土化全链条供给成为必然趋势

半导体行业是现代经济社会发展的先导性、战略性产业，是电子信息产业的基石。随着半导体产业技术进步、加工能力提升，以及下游市场需求扩大，

全球及中国半导体市场近年来呈现显著增长态势。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2018年至2025年全球半导体市场规模从4,688亿美元增长至7,917亿美元，年均复合增长率达7.77%；按中国半导体行业协会统计和预测，我国半导体产业销售额从2018年的9,190亿元扩大至2025年的21,367.7亿元，年均复合增长率高达12.81%。未来，在助力传统产业转型升级的同时，随着AI算力、智能终端、工业自动化、机器人、新能源与储能等新兴领域的蓬勃发展，作为底层技术支撑的半导体产业将保持高速增长势头。

作为全球电子产品制造大国及主要消费市场，中国电子信息产业持续快速发展，全球地位迅速提升，为中国半导体产业发展提供良好机遇，已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的半导体全产业链。但半导体产业链关键领域的“卡脖子”瓶颈、尚未完善的产业链协同生态，导致我国半导体产业在一些核心环节与欧美日韩等发达地区存在差距，高端芯片和半导体设备仍主要依赖进口。与此同时，国际地缘政治冲突、贸易争端频发、海外对华半导体出口管制，加剧高端半导体材料全球供应链的不确定性。在此背景下，提高半导体产业链的安全性和稳定性、打造半导体产业本土化全链条供给体系刻不容缓。

目前，我国政策端已将半导体产业提升至国家战略安全高度。2026年3月，“十五五规划纲要”明确提出，聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；2024年9月，《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》明确将集成电路生产装备、测量检测装备等列入重大技术装备名单，以促进重点技术装备的创新发展和推广应用，提升我国装备制造业的核心竞争力；2022年12月，《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路等技术创新和应用。产业“大基金”等国家资本与其他产业资本陆续向设备、材料、制造、设计、封装等产业链头部企业提供资源支持。

鼓励研发投入、完善产业生态、引入产业投资基金与政策支持多措并举，为半导体产业自主化升级进程形成强大助推力，引领境内半导体技术从“全面追赶”转向“重点突破”，加速本土技术自主创新的拐点到来，这也为境内半导体产业链相关设备企业的经营发展注入动力。

2、半导体核心设备国产化和下游行业需求提升为PVD设备应用开辟广阔空间

（1）半导体产业链

半导体产业链主要涵盖上游原材料与设备，中游芯片设计、晶圆制造与封装测试三大核心环节，下游应用终端。半导体专用设备作为产业链上游的关键支撑环节，是完成晶圆制造和封装测试的基础，在半导体产业链中具有极高的战略价值和产业地位。

在晶圆制造环节，光刻设备、刻蚀机和薄膜沉积设备是核心设备。其中，光刻设备用于将电路图案转移到硅晶圆上，是决定芯片制程先进程度的关键因素。依据所使用的光源类型和技术水平，光刻设备可分为可见光光刻设备、紫外光光刻设备、深紫外光刻设备、极紫外光刻设备等。深紫外光刻设备是目前主流的光刻设备之一，广泛用于主要成熟芯片制程，通过浸没式光刻与多重曝光技术结合，深紫外光刻设备可探索制造出7nm制程的先进芯片。2024年，我国在深紫外光刻技术领域实现突破，研发的国产KrF及ArF光刻设备已被列入首台（套）推广目录，境内对深紫外光刻设备产业化的部署让光刻应用逐步由境外垄断转为境内外共同发展；极紫外光刻设备则是制造7nm及以下先进制程芯片的关键设备，能显著提升芯片性能和集成度，是现阶段最尖端的光刻技术。紫外光刻设备将逐步实现本土化发展，境内厂商和科研院所正在加紧部署深紫外光刻设备技术开发和本土供应链搭建，境内极紫外光刻设备整体处于研究开发阶段，多家厂商及科研机构正积极研发整机或关键零部件，推动其产业化落地。

光刻设备整机研发、制造复杂，其中的投影物镜系统及其超精密光学元器件是影响光刻设备核心参数的主要组件。超精密光学元器件的光学膜能够调控光线透射、反射特性，有效降低散射损耗、消除杂光并减小像差，进而优化元器件的光学性能，这类光学膜对真空镀膜设备在膜层厚度、均匀性等方面提出更高镀膜技术要求。过去，光刻设备超精密光学元器件的镀膜需求主要由境外真空镀膜核心厂商满足，境内庞大存量深紫外光刻设备的关键配件有较大的本土化供应需求，加上境内半导体光刻设备开发工作不断推进，二者共同推动境

内超精密光学元器件企业不断自我突破，而该过程离不开国产真空镀膜设备的技术支撑与工艺保障。

芯片封装按工艺可分为传统封装和先进封装（包括倒装封装、晶圆级封装以及三维堆叠封装等）。当前半导体制程工艺逐渐逼近物理极限，业内开始寻求通过先进封装技术提升芯片整体性能，助力半导体产业“超越摩尔定律”，由此将催生对先进封装工艺相关设备的增量需求。

TGV归属于三维堆叠封装技术，是在玻璃基板上制造通孔并进行金属化处理的技术，相较于TSV技术使用的硅基板，玻璃基板凭借低损耗、高线性度以及优异的高频特性等优势，更适应高速信号互连的应用需求。TGV工艺通过垂直的电气互连通道，能够实现芯片在三维空间的高密度堆叠与集成，是芯片制程微缩技术制约下业界对先进制程芯片突破研发限制的一条重要路径。由于玻璃基板不具备导电性，TGV封装要先在玻璃基板的微孔表面沉积一层粘附层，以对玻璃形成强力的机械互锁和化学键合，再镀上导电层，为后续电镀填充铜打下基础。玻璃微孔镀膜对台阶覆盖率、拉拔力及附着力等指标提出严格要求，公司TGV微孔镀膜技术可以解决深径比大于15:1的通孔全覆盖镀膜、铜与玻璃材料粘附的难题，因此，TGV微孔镀膜设备是确保基板内芯片之间和基板上下层进行高速信号传输，实现更高芯片集成度，助力芯片先进封装工艺迭代发展的关键前提。TGV工艺还可应用于RF射频前端模组、光-电共封装、MicroLED等应用场景。目前算力、存力需求快速攀升，拉动全球玻璃基板市场步入增长新周期，境内厂商正积极追赶国际先进水平，部分境内企业已成功研制TGV玻璃基板并向下游客户送样，有望推进商业化进程，预期相关配套的TGV微孔镀膜等关键设备将受益。

综上，境内半导体产业技术进步对真空镀膜技术提出更高要求，而真空镀膜技术的升级迭代能促进境内半导体产业不断发展，二者相辅相成，驱动产业生态协同进步。目前，境外PVD镀膜设备厂商在配套超精密光学元器件和先进封装TGV工艺的研发、生产中处于优势地位，而半导体产业链本土化全链条供给的背景则为境内PVD镀膜设备厂商提供了良好的发展机遇。

（2）其他下游行业

连续式镀膜设备是一种在真空环境下，使镀膜源在整个生产过程中保持不间断工作状态的自动化镀膜系统。公司连续式镀膜设备自动化程度较高，普遍采用模块化设计思路，通过多工艺模块串联与自动化传输系统结合，从而实现从进料、前处理、镀膜到后道的全流程连续化作业，有效提升生产效率，降低能耗，确保高精度的膜厚控制和膜层质量，能够适配公司下游客户多样化的应用场景。受益于消费电子、汽车、新能源等下游行业对连续式生产需求的持续提升，公司连续式镀膜设备产品应用范围将得到扩大。

3、公司深耕真空镀膜领域，具有深厚的技术积累和强大的创新实力，并积极在半导体等应用领域进行布局

公司以真空镀膜技术为核心，长期致力于磁控溅射镀膜技术、蒸发镀膜技术、离子镀膜技术等真空镀膜技术的研究和应用。在人员配备上，公司已拥有具备持续创新能力的技术团队和管理队伍，在核心技术方面，公司已掌握真空腔体、温控系统、电弧蒸发源、磁控溅射阴极、离子源、自动控制系统等关键模块的自主研发能力，并搭建覆盖多类膜系的研发试验平台，能够为客户提供定制化的镀膜装备设计、制造及工艺解决方案。

公司深刻意识到半导体产业链对我国现代经济发展的战略地位，积极布局半导体设备高端应用领域的镀膜技术研发和储备，持续攻关超高真空技术、超高真空和高温环境下的高精度及高速运动控制、高深径比微孔内壁镀膜、静态磁控溅射镀膜等核心技术，已具备超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备等PVD设备的产业化能力。目前公司已陆续向部分高校、科研院所及已在以上相关产业布局的核心企业交付少量超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备，但相应产品的量产供应能力亟需提升。

基于现有技术及工艺积累，公司已持续向客户供应连续式镀膜设备产品，在消费电子、汽车、新能源等产业的竞争力得到强化，然而，面对下游行业对连续式镀膜产品的切实需求，公司亦需通过建设新场地以进一步提升该类产品的产能保障能力。

（二）本次发行股票的目的

1、满足超精密光学元器件与先进封装技术对PVD设备的升级需求，响应半导体产业链本土化全链条供给的国家战略

当前，超精密光学领域镀膜设备主要依赖境外厂商供应，在全球地缘政治冲突加剧、国际贸易争端频发、国产半导体光刻设备开发持续取得突破、境内存量光刻设备关键零配件维保替换需求日益凸显的背景下，解决超精密光学元器件镀膜设备国产化供应已成为当务之急。与此同时，我国TGV先进封装工艺发展迅速，境内先进封装厂商愈发倾向于与具备技术实力的国产镀膜设备供应商开展深度合作，以应对前沿封装技术挑战。因此，要实现超精密光学元器件与前沿先进封装技术的突破，离不开国产PVD设备的技术支撑与工艺保障。

报告期内，公司凭借已有技术工艺积累，开发适配半导体超精密光学元器件和先进封装工艺对镀膜环节要求的PVD设备。公司本次募集资金投资项目旨在形成超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备等PVD设备的自主生产能力，以满足下游半导体产业日益增长的市场需求，是公司响应半导体产业链本土化全链条供给的国家发展战略、助力提升半导体设备及其关键零部件国产化率、支撑半导体产业链安全稳定运行的重要举措。

2、完善公司产品和技术在半导体高端应用领域以及消费电子、汽车、新能源等下游行业的业务布局，提升全流程生产能力，筑牢公司核心竞争力

公司长期致力于溅射镀膜、蒸发镀膜、离子镀膜等真空镀膜技术以及成膜工艺的研究与应用，生产的各类真空镀膜设备已广泛服务于消费电子如智能手机、光学镜头，其他消费品如家居建材、生活用品，工业品如半导体、航空等领域，前述行业在产业结构性升级过程中对产能更大、自动化水平更高、生产效率和成本更具优势的连续式生产设备需求将不断增加。本次募集资金拟投向的“超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目”与公司现有核心技术、应用领域具备高度关联性，是公司PVD设备在镀膜厚度、控制精度、环境真空度等参数指标的优化与升级，是适配下游半导体领域客户需求以及其他下游客户连续式生产应用场景的重要举措，本次募投项目实施后将进一步提高公司在半导体、消费电子、汽车、新能源等下游行业的参与度。

本次募投项目拟设计高等级洁净生产车间，并引进自动化生产设备、表面处理等配套设备及管理系统，形成大型腔体精密加工与表面处理能力，满足大型镀膜设备对核心部件精密制造与预处理的需求、打造适配更高精度的PVD设备的生产基地。本次募投项目实施后，公司将提升超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备、连续式镀膜设备等PVD设备的供应能力，促使公司产品优势、技术优势转化为市场竞争优势，丰富公司产品层次和应用领域；充分满足下游客户对更高精度PVD工艺的需求，支持公司开拓并深度绑定下游头部客户资源，保障公司对客户配套服务的响应能力，从而增强公司市场竞争力。

3、增强资金实力、优化财务结构，为公司战略实施与可持续发展提供坚实保障

本次发行募集资金到位后，公司股权资本得以补充，资产负债结构进一步优化，有利于公司提高财务稳健性和抗风险能力。同时，本次募集资金能为公司技术升级成果的产业化落地和经营效率提升提供资金保障，为公司人才引进、业务拓展等提供持续性支持，有利于公司匹配行业发展诉求，筑牢公司行业地位，为公司未来业绩增长、战略实施提供长效驱动力，后续募投项目效益的逐步释放也将提升公司整体经济效益。此外，补充流动资金亦能满足公司经营规模增长所带来的营运资本需求，为公司可持续发展提供坚实保障。

三、发行对象及其与公司的关系

公司本次发行的发行对象不超过 35 名（含本数），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所相关规定协商确定，若发行时法律、法规或规范性文件

对发行对象另有规定的，从其规定。

本次所有发行对象均以人民币现金方式、以同一价格认购本次发行的股票。

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

四、本次发行方案概述

（一）发行股票的种类及面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，在通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在批复有效期内择机发行。

（三）发行对象及认购方式

公司本次发行的发行对象不超过 35 名（含本数），包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内根据询价结果，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及深交所相关规定协商确定，若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

本次所有发行对象均以人民币现金方式、以同一价格认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票采取询价发行方式，定价基准日为公司本次发行股票的发行

期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整，调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

本次发行的最终发行价格将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，同时不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 3,000 万股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出同意注册的决定后，由公司董事会根据股东会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或因股权激励、股权回购注销等事项导致公司股本发生变化，则本次向特定对象发行的发行数量上限将作相应调整。

（六）限售期

本次向特定对象发行股票，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象取得的本次向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增

等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深交所的相关规定执行。

（七）募集资金金额与用途

本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过人民币 95,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目	76,485.30	66,861.68
2	补充流动资金	28,638.32	28,638.32
合计		105,123.61	95,500.00

本次募集资金到位前，公司可根据募投项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

（八）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

（九）上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在深交所创业板上市交易。

（十）本次发行决议有效期

本次向特定对象发行股票的决议有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。公司在上述有效期内取得深交所对本次向特定对象发行 A 股股票的审核同意并在中国证监会完成注册，则上述决议有效期自动延长至本次向特定对象发行 A 股股票实施完成日。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司尚未确定本次发行具体对象。最终是否存在因关联方认购本次定向发行的股票而构成关联交易的情形，将在本次发行结束后相关公告中予以披露。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，公司无控股股东，实际控制人为罗志明、李志荣、李志方、李秋霞，该四人为同胞兄弟姐妹，于2020年7月8日签署一致行动协议，约定其作为公司股东及/或董事将在公司股东会和董事会上就所有决策事宜保持一致行动，四人合计直接及间接持有公司54.09%的股份，为公司共同实际控制人。

按照本次发行股票数量上限即本次发行前公司总股本的30%预计，本次发行完成后，罗志明、李志荣、李志方、李秋霞仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。

七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件

本次发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）已履行的审批程序

公司本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司于2026年8月10日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

（二）尚需履行的审批程序

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定，本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。

在通过深交所审核并完成中国证监会注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记与上市等事宜。

上述呈报事项能否获得相关批准以及获得批准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 95,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目	76,485.30	66,861.68
2	补充流动资金	28,638.32	28,638.32
合计		105,123.61	95,500.00

本次募集资金到位前，公司可根据募投项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析

（一）超精密半导体及连续式PVD设备产业化项目

1、项目基本情况

公司“超精密半导体及连续式 PVD 设备产业化项目”将于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区实施，建设高等级洁净车间和优化生产布局，并引入自动化产线及配套设备，打造适配更高精度的 PVD 设备生产的先进制造基地。项目建成后，将形成超精密光学镀膜设备、TGV 微孔镀膜设备及连续式镀膜设备等 PVD 设备的自主生产能力，强化公司对全流程工艺环节的精准管控与体系化保障，推动国产 PVD 设备在半导体、消费电子、汽车、新能源等重点产业的关键应用，以更好地满足下游市场持续增长的需求，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。

序号	产品名称	产品简介
1	超精密光学镀膜设备	该设备依托磁控溅射镀膜、蒸发镀膜、离子镀膜等PVD

序号	产品名称	产品简介
		技术，在超高真空环境下，制备应力低、界面缺陷少、膜层致密、高均匀性且厚度控制达到原子层级的光学膜层，满足高精度光谱特性及各项技术参数要求，主要应用于半导体光刻设备的反射镜、透镜等超精密光学元件的真空镀膜
2	TGV微孔镀膜设备	该设备依托磁控溅射镀膜PVD技术，通过对入射粒子的能量和方向进行控制，使镀膜材料在微孔内具备良好穿透性，实现高深径比（孔径小、深度大）的玻璃孔内镀上厚度均匀、覆盖完整的薄膜
3	连续式镀膜设备	该设备采用模块化设计思路，依托磁控溅射镀膜、蒸发镀膜、离子镀膜等PVD技术工艺，多工艺模块串联与自动化传输系统结合使镀膜源保持不间断工作，实现进料、镀膜到出料的全流程连续化作业，主要应用于消费电子、汽车、新能源等下游行业

2、项目实施的必要性

（1）近年来在半导体产业重心向中国大陆转移和产业链本土化全链条供给需求日益迫切的背景下，境内半导体产业迎来重要的战略发展窗口期

半导体产业作为基础性战略新兴产业，不仅是人工智能、机器人、工业自动化、智能驾驶、消费电子等产业高速发展的主引擎，更是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展水平直接关系国家综合实力和安全保障能力。

行业数据显示，近年来半导体产业整体保持稳步发展，且结构上呈现向中国大陆转移的趋势。根据 WSTS 统计，2018 年至 2025 年全球半导体市场规模从 4,688 亿美元增长至 7,917 亿美元，年均复合增长率达 7.77%；按中国半导体行业协会统计和预测，我国半导体产业销售额从 2018 年的 9,190 亿元扩大至 2025 年的 21,367.7 亿元，年均复合增长率高达 12.81%。中国半导体行业协会预测数据显示，2025 年中国芯片设计行业销售额已超 8,000 亿元，同比增长 29.4%，行业内已涌现出一批具有代表性的国产龙头企业。Knometa Research《全球晶圆产能报告》（2024 年度），预计到 2026 年中国大陆晶圆产能占全球的份额将提升至 22.3%。根据 Trend Force 集邦咨询数据，2025 年全球前十大封测厂商中已有五家来自中国大陆，显示出中国大陆在半导体封测环节不断增强的竞争力。

然而，截至目前境内半导体设备及其关键零部件、核心材料的自给率水平

仍然较低，已成为制约我国半导体产业自主健康发展的主要因素。面对国际地缘政治冲突、外部贸易争端和技术封锁给境内半导体供应链带来的不确定性，实现核心环节的本土化全链条供给已成为境内半导体产业发展的必经之路。为加速半导体产业国产化进程，各方正协同发力：首先，政策层面持续加大对芯片设计、晶圆制造、封装测试等关键环节技术突破的支持力度；其次，产业“大基金”等国家资本以及社会资本赋能，助力产业建立多渠道融资支持，增强产业发展信心；此外，高校、科研院所、半导体厂商等创新主体正积极通过产学研融合，持续研发创新，共同推动产业迈向高质量发展新阶段。

（2）国产PVD真空镀膜设备助推境内半导体核心环节工艺升级

光刻工艺直接决定半导体制程水平，超精密光学元器件作为光刻设备的投影物镜系统核心部件，其性能直接关系到光刻设备的分辨率和套刻精度等关键技术参数。因此，先进制程光刻设备对光学元器件的精度要求极高，例如，顶级单反相机镜头加工产生的像差通常在 200nm 以上，而 ASML 的 ArF 深紫外光刻设备投影物镜像差需控制在 2nm 内。PVD 真空镀膜工艺能有效提升超精密光学元器件的性能，包括优化镜片透光率和反射率、改善色散性能、消除杂光并增强表面抗损伤能力。本次募投项目规划的超精密光学镀膜设备主要应用于制备先进制程光刻设备中超精密光学元器件的光学薄膜，以满足境内半导体产业自主化发展对光刻设备超精密光学元器件的真空镀膜技术在膜层厚度、均匀性、结合力与稳定性等方面提出的更高要求，提升超精密光学元器件的综合性能，适配国内半导体光刻设备的发展需求。

目前，半导体光刻设备及其关键零部件由境外厂商主导供应，在产业链本土化全链条供给的背景下，国产光刻工艺发展进程加快：紫外光刻设备将逐步实现国产化，2024 年首台国产 KrF、ArF 光刻设备已得到推广应用；光学器件厂商加快开发未来能够批量供应深紫外光刻设备的超精密光学元器件；多家厂商及研究机构正在积极研发极紫外光刻设备整机或关键零部件，推动其产业化落地。同时，境内超过千台存量深紫外光刻设备的关键配件也有较大的维护更换需求。因此，境内国产光刻设备开发和存量光刻设备维保服务将共同催生国产超精密光学元器件对配套高精度镀膜工艺的需求。

当前半导体制程工艺逐渐逼近物理极限，通过先进封装技术提升芯片整体

性能已成为半导体行业重要发展方向，TGV 三维堆叠封装是其中的关键技术路径之一，它通过在玻璃内部制造垂直通孔，完成多层芯片堆叠，从而提升封装效率和散热性能，与 TSV 技术所使用的硅基板相比，TGV 工艺使用的玻璃基板具有低损耗、高线性度以及优异的高频特性等优势，更适用于高速信号的互连。公司本次募投项目规划的 TGV 微孔镀膜设备可应用于先进封装的 TGV 工艺微孔内壁涂层镀膜。TGV 微孔镀膜设备依托高阶磁控溅射等核心技术，可以解决深径比大通孔的全覆盖镀膜、铜与玻璃材料粘附的难题，提升垂直导体的电气性能和可靠性，确保基板内芯片之间和基板上下层进行高速信号传输。目前境内已有多家厂商积极开发 TGV 方案，致力于追赶国际先进水平，积极推进商业化进程。

（3）连续式设备将进一步打开 PVD 国产化空间，本次募投项目实施将助力公司巩固在境内所属行业的领先地位

真空镀膜技术起源于国外，目前，全球真空镀膜市场呈现出以德国莱宝为代表的国际领先企业长期占据主导地位的竞争格局，而 PVD 设备行业具有技术复杂、研发周期长、投资规模大、参与门槛高的特点，后起的境内厂商整体仍处于追赶阶段。当前真空镀膜技术应用已从较为传统的五金、塑胶、建筑等领域不断延伸至半导体、消费电子、汽车、新能源等领域，其中消费电子、汽车、新能源等进入成熟发展期产业则呈现专业分工更加精细的发展趋势，行业资源进一步向头部厂商集中，头部厂商以提升综合运营效率为核心战略导向，持续推动生产体系的优化升级，对产能更大、自动化水平更高、生产效率和成本更具优势的连续式镀膜设备需求将不断增加。

因此，本次募投项目的实施，不仅有助于公司增加连续式镀膜设备的自主产能，强化主业竞争力，是巩固公司在境内 PVD 行业领先地位的重要举措，而且从全局来看，将推动消费电子、汽车、新能源等国民经济重要行业的生产设备国产化率不断提升。

（4）本次募投项目实施是公司推动更高精度的 PVD 设备产业化落地，发展新质生产力的重要战略决策

公司持续优化技术工艺，已成功研发出应用于超精密光学元器件和三维堆

叠封装 TGV 方案的 PVD 设备，并陆续向部分高校、科研院所以及相关厂商交付少量产品，且已持续向下游各行业客户供应连续式镀膜设备。

超精密光学镀膜设备和 TGV 微孔镀膜设备的制造精度要求较高，对全流程生产环境洁净度、温湿度、振动及静电防护等指标要求严格，外协加工在工艺控制和洁净环境保障方面难以满足相关要求，且半导体客户十分关注设备生产保密性，因此公司有必要构建全流程的自主生产能力。而连续式镀膜设备占地面积大，对生产场地面积、承重要求高。然而，公司正面临着生产场地制约：鸡翅岭厂区为 IPO 募投项目研发生产基地实施地点，已于 2021 年达到预定可使用状态且投入使用，目前场地已得到充分利用；颜屋村厂区存在建筑结构、生产布局不合理以及设施老化等不足，且受地块区位因素影响，调整空间有限，无法满足现代化生产线布局和设备组装调试的需求。

因此，本次募投项目将建设高等级洁净车间，引进自动化生产线及智能管理系统，形成大型腔体精密加工与表面清洗处理能力，打造适配更高精度的 PVD 设备的生产基地。这一举措将强化公司自主生产能力，保障公司产品品质和稳定交付能力，推动相关 PVD 设备产业化落地，更好地响应多领域下游客户的需求，符合新质生产力发展方向。

3、项目实施的可行性

（1）国家政策引领为半导体设备行业本土化发展提供强有力保障

半导体行业作为国家战略新兴产业，近年来在政策持续赋能下进入高速发展期。2022 年 12 月，国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》提出全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、集成电路等技术创新和应用。2023 年国务院有关部门发布《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。2024 年 9 月，中华人民共和国工业和信息化部印发的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）》明确将半导体生产设备、测量检测装备等纳入重大技术装备范畴，推动自主研发和应用，提升我国装备制造业的核心竞争力。2026 年 3 月，“十五五规划纲要”明确提出，聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，

全链条推动集成电路、工业母机等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。在顶层政策的引领下，产业“大基金”向设备、材料、制造、设计、封装等半导体全产业链纵深推进，通过对龙头企业的重点扶持，护航产业行稳致远。

半导体设备作为我国半导体产业的基石，其持续稳定的供应直接关系到产业链的健康发展。本次募投项目投产面向超精密光学、先进封装等半导体产业链核心环节所需要的PVD设备，推动半导体设备及核心部件本土化供应进程，高度契合国家战略方向，使公司有望在真空镀膜设备的本土化发展浪潮中抢占先机。

(2) 广阔的市场发展前景为项目产能释放奠定坚实基础

半导体设备市场景气度高，具备持续增长潜力。根据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2025年全球半导体设备销售额为1,351亿美元，其中中国大陆市场占比达到37%，已连续多年成为半导体设备最大单一销售市场；预计未来在人工智能相关需求持续增长的带动下，2026年和2027年将增长至1,450亿美元和1,560亿美元。尽管我国半导体设备产业整体起步较晚，但在国家推动产业链本土化全链条供给的战略背景下，中国大陆作为全球最大的半导体设备销售市场，将为本土设备厂商带来发展机会。从本次募投项目产品的具体应用领域来看：A、境内存量光刻设备的超精密光学元器件等关键配件维保替换需求，以及半导体光刻设备国产化进程加速，为公司的超精密光学镀膜设备开辟广阔的市场空间；B、机器人、人工智能、光通信等产业的蓬勃发展拉动对芯片先进封装的需求，公司的TGV微孔镀膜设备凭借其在高深径比微孔、强膜层附着力等方面的技术优势，能够提升先进封装工艺下的芯片性能，契合下游客户对高性能封装解决方案的迫切需求。

连续式镀膜设备依托公司已持续深耕的消费电子、汽车、新能源等下游领域，采用模块化、定制化配置方案，可满足多样化生产应用场景。全球消费电子市场规模稳步增长，据东莞证券研究所数据，到2030年前后全球消费电子市场规模将突破1.1万亿美元，2025-2030年复合增长率为2.81%，随着AI技术深度赋能产品创新迭代，各类显示面板的镀膜加工需求将得到持续带动。我国汽车产业规模持续扩容，据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车产销量均突破3,400万辆，再创历史新高，伴随新能源汽车渗透率持续提升，挡风玻璃、

调光玻璃、HUD 等车载光学部件的镀膜需求同步释放。光伏产业保持高速发展态势，据国家能源局数据，截至 2025 年末全国光伏发电装机容量已达 12 亿千瓦，同比增长 35%，太阳能电池的 PVD 镀膜是提升光电转换效率的核心技术之一，PVD 的定位已从单一的电极制备，升级为覆盖吸收层、透明导电膜、缓冲层及复杂金属化的全流程关键环节。在锂电池领域，复合铜箔、铝箔镀膜等新兴应用逐步增加。上述多重因素叠加，推动下游市场对连续式镀膜设备的需求持续攀升。

目前公司凭借深厚的真空镀膜技术积累与经验，已成功研发出应用于超精密光学元器件和三维堆叠封装 TGV 方案的 PVD 设备，并已陆续向部分高校、科研院所以及相关的核心厂商交付少量产品，同时公司积极开拓多家潜在客户，以持续扩大在半导体领域的客户基础。连续式镀膜设备已应用于消费电子、汽车、新能源等下游领域。因此，广阔的下游市场空间和公司不断开拓的客户资源将为本次募投项目产能的消化提供坚实基础。

(3) 公司具备本次募投项目产品落地的技术储备和生产经验

公司系境内领先的PVD真空镀膜设备企业，长期专注于镀膜设备的研发、设计与制造。在人员配备上，公司已组建具备持续创新能力的技术团队和成熟的管理队伍，能够对行业发展趋势和下游市场需求保持敏锐洞察力。在核心技术方面，公司已掌握真空腔体与系统设计、温控系统、电弧蒸发源、磁控溅射靶等关键模块的自主研发能力，并搭建覆盖多类膜系的研发试验平台，能够适配多种基材和各类靶材或蒸发源的镀膜应用需求，为客户提供定制化的镀膜装备及工艺解决方案。此外，公司先后被评为第三批国家级“专精特新‘小巨人’企业”、广东省“真空镀膜应用工程技术研究中心”、广东省制造业单项冠军、东莞市工业设计中心，积极参与多项行业标准制定。截至2026年6月30日，公司及其子公司共拥有137项专利（其中发明专利50项）和7项软件著作权。

公司在已有的真空镀膜工艺基础上持续对镀膜技术进行迭代升级，前瞻性布局超高真空技术、超高真空和高温环境下的高精度及高速运动控制、高深径比微孔内壁镀膜、静态磁控溅射镀膜等关键技术的开发，进一步提高腔体真空度、膜层材料粒子运动精确控制度，减少镀膜过程中的颗粒缺陷，并严格控制设备内的有机物污染，可以满足半导体以及消费电子、汽车、新能源等领域客

户对超精密光学镀膜设备、TGV微孔镀膜设备、连续式镀膜设备等PVD设备的需求。目前公司已陆续向部分高校、科研院所及已在以上相关产业布局的核心企业交付少量超精密光学镀膜设备和TGV微孔镀膜设备，同时公司已持续向下游客户供应连续式镀膜设备。

综上，本次募投项目具备政策支持、市场消化空间和研发技术积累等实施条件，项目投产后有望提升公司在半导体产业链的参与度，增强公司核心竞争力。

4、项目实施主体和投资概况

本次募投项目由汇成真空母公司实施。本项目建设期预计为2年，预计总投资额76,485.30万元，其中使用募集资金66,861.68万元。

5、项目用地、备案和环评情况

（1）项目用地。公司已经与天弘科技签署《厂房及土地使用权转让协议》，约定天弘科技将位于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业北路5号的相关土地及房屋建筑物转让给公司，拟转让的土地使用权及房屋建筑物价值已经由中水致远资产评估有限公司评估（中水致远评报字[2026]第220158号）。

（2）项目备案、环评情况。截至本预案公告日，本次募投项目已经东莞市发展和改革局备案登记，备案编号为2607-441900-04-01-615888。本次募投项目环境影响评价等审批手续正在办理中，公司将积极按照相关规定要求完成环评批复程序。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

公司以实际经营情况为基础，综合考虑现有的资金情况、资本结构、运营资金需求缺口与未来战略发展目标，拟将本次募集资金中的28,638.32万元用于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求，增强公司核心竞争力，助力公司可持续发展。

2、补充流动资金的必要性

（1）为公司未来持续发展提供资金保障

设备制造业属于资金密集型行业，研发投入大、运营链条长，因此，企业持续发展需要在技术研发和生产经营环节铺底大量资金。近年来，半导体、新能源等新兴行业持续发展，对真空镀膜设备的需求量有所增长，加之高性能真空镀膜设备本土化发展浪潮以及环保政策鼓励真空镀膜技术替代传统工艺等多重利好因素的驱动，真空镀膜设备行业迎来良好发展机遇期。公司始终坚持以产品升级为导向，持续优化核心工艺、探索新材料应用，不断提升设备在镀膜精度、效率、质量等方面的性能，并进一步丰富产品线，优化资源配置，有效满足下游客户对中高端真空镀膜设备的升级需求。公司本次发行部分募集资金拟用于补充公司流动资金，将为公司业务持续发展和技术创新提供必要的资金，实现公司长期发展战略。

（2）拓展公司融资渠道，提升抗风险能力

公司现有营运资金主要依赖内部经营积累和银行贷款，前者多用于满足日常生产运营的周转需要，而银行贷款存在额度受限、受信贷政策波动影响较大以及对增信措施要求较高等局限性，现有的融资渠道无法充分支撑公司把握市场机遇、满足业务发展对营运资金的长期需求。本次定向发行募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效满足，资产结构更加稳健，可进一步提升公司的整体抗风险能力。

3、补充流动资金的可行性

（1）本次发行部分募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

公司本次发行部分募集资金拟用于补充公司流动资金，用于公司主营业务，符合国家产业政策发展要求和公司当前战略规划，有利于提升公司持续经营能力，实现长期稳健发展。本次募集资金部分用于补充流动资金符合《注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》中关于募集资金使用的相关规定，方案具备可行性。

（2）公司内部治理规范，内控完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立以法人治理为核心的现代企业制度，形成规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集

资金的管理和运用，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出明确的规定，从而在制度上保证募集资金的规范使用。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督其存储及使用情况，从执行层面确保募集资金使用合规，并有效防范风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入应用于半导体、消费电子、汽车、新能源等领域的PVD设备产能建设项目及补充流动资金，均围绕公司主营业务领域展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票完成后，公司的总资产和净资产规模将有所增长，营运资金进一步充实，同时，公司资产负债率将相应下降，有利于公司优化资本结构、提高抗风险能力。

随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司运营规模 and 经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回报，促进公司健康发展。

四、本次募集资金使用的可行性结论

本次发行募集资金投向符合国家相关的产业政策、行业发展趋势以及公司整体战略规划。同时，本次募投项目的实施，将进一步优化公司资本结构，提升公司综合实力，有利于公司长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。综上所述，公司规划实施本次募投项目是必要且可行的。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况

（一）公司业务及资产整合计划

本次发行募集资金将用于：1、“超精密半导体及连续式 PVD 设备产业化项目”，以实现超精密光学镀膜设备、TGV 微孔镀膜设备、连续式镀膜设备等 PVD 设备的产能储备；2、补充公司主营业务所需流动资金。前述募集资金的投向符合国家相关产业政策以及公司整体发展战略。本次募投项目顺利实施将有助于提升公司在真空镀膜设备行业的核心竞争力和市场地位，增强业务规模和盈利能力，提升上市公司整体价值。

本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

（二）公司章程变化情况

本次发行完成后，公司的股本总额将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，截至本预案公告日，公司无其他修改《公司章程》的计划。

（三）股东结构变化情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，股东结构和原股东持股比例将发生变化，但不会导致公司股权分布不符合上市条件。

截至本预案公告日，公司无控股股东，实际控制人为罗志明、李志荣、李志方、李秋霞。按照本次发行股票数量上限（即本次发行前公司总股本的 30%）预计，本次发行完成后，罗志明、李志荣、李志方、李秋霞仍为公司实际控制人，不会导致公司控制权发生变化。

（四）高管人员结构变化情况

本次发行不会导致公司高级管理人员的结构发生变动，截至本预案公告日，

公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高级管理人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）业务结构变化情况

本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入应用于半导体、消费电子、汽车、新能源等领域的 PVD 设备产能建设项目及补充流动资金，均围绕公司主营业务领域展开，有助于公司优化产品结构、延伸应用领域、完善业务布局。因此，本次发行完成后公司的业务结构不会发生重大变化。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，资产结构进一步优化，有利于增强公司偿债能力，降低公司财务风险，提高公司资信水平和抵御风险能力，为公司后续发展提供良好保障。

（二）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司总股本及净资产总额将较大幅度增加，短期内可能导致净资产收益率下降，每股收益被摊薄。但本次募投项目围绕公司主营业务开展，有助于提升公司在真空镀膜设备行业的核心竞争力和市场地位，随着投资项目实施与经济效益的释放，公司长期盈利能力也将有所提升。

（三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，使用募集资金新建项目的投资活动现金流出也将增加，并缓解公司日益增长的日常营运资金需求所致的现金流压力；本次发行募集的流动资金到位，有利于扩大公司经营规模，相应提升未来经营活动现金流入，此外，待募集资金投资项目如期完成并产生效益之后，公司盈利能力也将不断提高，公司的经营活动现金流入将进一步提升。

三、公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

截至本预案公告日，公司无控股股东，实际控制人为罗志明、李志荣、李志方、李秋霞。本次发行完成后，公司实际控制人不会发生变化，本次募投项目围绕公司主营业务开展，公司与实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系均不会发生重大变化，也不会因本次发行形成同业竞争和新的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

公司不会因本次发行而存在资金、资产被实际控制人及其关联人占用的情形，亦不会存在公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

五、本次发行对公司负债情况的影响

本次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率降低。本次发行不会增加公司负债（包括或有负债）。本次发行能促使公司资本结构更趋合理，进而提高公司抗风险能力和持续经营能力，有助于公司长期可持续发展。

六、本次发行的相关风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票时，除本预案披露的相关信息外，应特别考虑下述各项风险因素：

（一）发行相关风险

1、审核风险

本次发行尚需公司股东会批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。前述批准或注册程序事项能否取得存在不确定性，最终取得批准或注册的时间亦存在不确定性，公司将根据信息披露要求及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注意审批风险。

2、发行风险

本次发行结果受证券市场整体走势、公司股价波动、投资者对公司及本次发行方案认可度等多种因素的叠加影响。因此，本次发行存在未能足额募集资金甚至发行失败的风险。

3、即期回报摊薄风险

本次发行完成后，公司的股本及净资产规模有所增加，而募投项目从建设、投产到产生经济效益尚需一定时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务；此外，募投项目的实施、补充流动资金的陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此，每股收益或净资产收益率等即期回报指标短期内可能被摊薄。

（二）业务经营风险

1、经营业绩波动风险

最近三年一期，公司营业收入分别为 52,211.44 万元、52,030.05 万元和 46,967.29 万元和 11,351.74 万元，净利润分别为 8,107.55 万元、6,809.09 万元、2,225.32 万元和 2,749.33 万元，2025 年公司净利润出现阶段性下滑，主要系下游客户需求波动及公司客户结构战略调整等因素综合影响所致。截至 2026 年 6 月末，公司在手订单充足，主要交期集中在 2026 年下半年及 2027 年，整体经营情况稳定。公司经营业绩受宏观经济环境、行业政策、市场竞争程度、下游需求变化等诸多因素影响，若未来前述因素出现不利变化，将可能影响公司收入、盈利水平，导致公司经营业绩出现波动。

2、市场竞争加剧风险

真空镀膜设备应用领域广泛，不同领域镀膜工艺和技术水平差距较大。国内厂商由于发展起步较晚，技术基础薄弱、人才紧缺，目前在市场地位及技术能力方面与国外企业尚存在一定差距，真空镀膜行业大部分高端市场份额及行业较大部分利润仍由国外企业占据。若公司无法进一步提高产品设计研发能力及市场开拓能力，公司将可能出现真空镀膜设备竞争力不足、无法进一步参与高端市场竞争的情况，从而面临市场竞争风险，对公司经营业绩产生不利影响。

3、规模扩张带来的管理风险

随着公司本次发行完成、募集资金到位、募投项目启动和各项业务开展，公司的资产规模与经营规模不断扩大，这对公司的人员管理、财务规范、内部控制、风险管控等各方面提出更高的要求。如果公司的管理体系不能适应业务快速发展的需求，将对公司生产经营造成不利影响。

4、技术人才流失风险

真空镀膜设备是集材料、物理、化学、机械、自动控制等多学科为一体的较为复杂的机器设备，不同行业的客户对真空镀膜的基材、靶材/蒸发源、技术标准、功能性要求、应用场景不尽相同，这一特点决定真空镀膜设备具有较高的定制化属性，产品设计开发过程依赖技术人才的研发能力和工作经验，因此维护研发团队稳定并吸引技术人才加入至关重要。如果公司不能有效保持核心技术人员激励机制，不能根据客户需求和技术升级而不断完善人才培养机制，有可能导致核心技术人员流失，从而对公司的项目实施和未来发展造成不利影响。

（三）募集资金投资项目风险

1、募投项目新增产能消化风险

本次发行募集资金拟投向“超精密半导体及连续式 PVD 设备产业化项目”，以实现超精密光学镀膜设备、TGV 微孔镀膜设备、连续式镀膜设备等 PVD 设备的产能储备。该投资项目不仅契合国家产业发展导向，而且与公司的战略规划及日常运营需求紧密相连，具备较强的可行性和实施的必要性。然而，本次发行的募集资金投资项目的实施和效益的实现需一定时间，项目的启动、实施、完工、达产以及最终产品的销售均存在不确定性。若在项目实施期间，未来宏观经济、相关产业政策、市场竞争格局等外部环境发生重大不利变化或下游客户需求增长、公司市场开拓不及预期，将可能导致公司本次募投项目新增产能无法顺利消化。

2、募投项目效益不及预期风险

本次定向发行所募集资金将投向“超精密半导体及连续式 PVD 设备产业化项目”，根据项目可行性分析和论证，本次募投项目具备良好的市场前景和经济效益，但项目投产至产能完全释放需要一定时间，在此期间，新增固定资产、

无形资产折旧摊销费用对公司经营业绩影响较大，若宏观经济、产业政策、市场需求、竞争格局、公司经营状况等发生不利变化，均可能导致募投项目实际效益不及预期。

（四）股票价格波动风险

本次发行将对公司未来经营成果和财务状况等基本面产生一定影响，可能会导致公司股票市场价格的波动，从而对投资者造成影响。此外，公司股票价格还受宏观经济形势、国家宏观政策、资本市场走势、市场心理预期、股票供求关系以及各类重大突发事件等多种因素的影响，存在一定的波动风险。投资者在作出投资决策时，应合理预计前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况

一、公司现行利润分配政策的相关规定

为建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件要求，公司在《公司章程》中对利润分配政策进行明确规定。

公司现行《公司章程》对于利润分配政策规定如下：

“第一百五十八条 公司的利润分配政策如下：

1、公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对股东的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

2、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式；现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。

3、公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。

4、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（1）现金分红的条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且能够保证公司能够持续经营和长期发展；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3000 万元；②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%；③中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

如不满足现金分红条件，公司可采取股票股利的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。

如进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要，且公司已在相关重大投资计划或重大现金支出等公开披露文件中进行说明，则不实施现金分红。

（2）现金分红比例：

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

5、公司股票股利分配的条件为：

(1) 公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正；

(2) 根据公司经营情况，董事会可以在满足上述现金分红之余，提出并实施股票股利分配预案，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

6、公司利润分配方案的决策程序和机制如下：

(1) 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制定。

(2) 独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。

(3) 审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当督促其及时改正。

(4) 董事会审议通过利润分配方案后报股东会审议批准。

(5) 股东会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。

(6) 公司独立董事可以在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

7、公司董事会应至少每三年制定一次股东回报规划。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，公司确需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分考虑公司独立董事和公众投资者的意见，调整后的股东回报规划不得违反法律、法规、规范性文件以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

8、公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，提交董

事会审议，董事会审议通过后提交股东会特别决议的方式（即经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上）审议通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。”

二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况

公司于2024年6月5日在深交所创业板上市，截至本预案公告日，公司上市未满三年。

（一）最近三年利润分配情况

1、2023 年度利润分配情况

2023 年度，公司未进行利润分配。

2、2024 年半年度利润分配情况

2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过《关于利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），合计 25,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2024 年年度利润分配情况

2025 年 5 月 14 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计 20,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2025 年半年度利润分配情况

2025 年 9 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计 10,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

5、2025 年年度利润分配情况

2026 年 5 月 11 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过《关于公司 2025

年度利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计 10,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）最近三年现金分红情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润合计为 6,500.00 万元，占最近三年平均归属于上市公司股东的净利润的比例为 113.76%，超过 30%，公司的利润分配符合中国证监会、深交所的相关规定。

单位：万元			
项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（含税）	2,000.00	4,500.00	-
合并报表归属于上市公司股东的净利润	2,225.32	6,809.09	8,107.55
最近三年累计现金分红合计	6,500.00		
最近三年合并报表归属于上市公司股东的年均净利润	5,713.99		
最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表归属于上市公司股东的年均净利润	113.76%		

（三）最近三年未分配利润的使用情况

为保持公司的可持续发展，结合实际经营情况，公司将历年滚存的未分配利润用于公司主营业务发展，以满足各项业务拓展的资金需求。在合理回报股东的前提下，公司上述未分配利润的使用有利于公司提高市场竞争力和盈利能力，符合公司全体股东利益。

三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，制定《广东汇成真空科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。上述规划已经公司第三届董事会第八次会议审议通过并对外披露，具体内容详见相关信息披露文件。

第五节 本次发行摊薄即期回报分析、采取措施及相关主体承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行事项对即期回报可能造成的影响进行分析，结合实际情况提出填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出承诺，具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势、产品市场情况及公司经营环境等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次发行于2026年11月末实施完毕，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、假设按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，发行30,000,000股（含本数）。前述向特定对象发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、在预测公司总股本时，以截至本预案公告日的公司总股本100,000,000股为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、根据公司已披露的 2025 年年度财务报告数据，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 2,225.32 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2,191.88 万元。以此数据为基础，根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，对于公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润，假设按以下三种情况进行测算：（1）较 2025 年度增长 200%；（2）较 2025 年度增长 100%；（3）较 2025 年度持平。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测和盈利承诺。

7、假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本因素的影响。

8、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2026 年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的公司不承担赔偿责任。特此提醒投资者注意。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设条件，公司测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
本次向特定对象发行股份数量（股）			30,000,000
总股本（股）	100,000,000	100,000,000	130,000,000
情景一：较2025年度增长200%			
归属上市公司股东的净利润（万元）	2,225.32	6,675.96	6,675.96
归属上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益）（万元）	2,191.88	6,575.63	6,575.63
基本每股收益（元/股）	0.22	0.67	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.67	0.65
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.22	0.66	0.64
稀释每股收益（扣除非经常性损益）	0.22	0.66	0.64

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
（元/股）			
情景二：较2025年度增长100%			
归属上市公司股东的净利润（万元）	2,225.32	4,450.64	4,450.64
归属上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益）（万元）	2,191.88	4,383.76	4,383.76
基本每股收益（元/股）	0.22	0.45	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.45	0.43
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.22	0.44	0.43
稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.22	0.44	0.43
情景三：较2025年度持平			
归属上市公司股东的净利润（万元）	2,225.32	2,225.32	2,225.32
归属上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益）（万元）	2,191.88	2,191.88	2,191.88
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.22
基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.22	0.22	0.21
稀释每股收益（扣除非经常性损益）（元/股）	0.22	0.22	0.21

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的股本及净资产规模有所增加，而募投项目从建设、投产到产生经济效益尚需一定时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务，因此，每股收益或净资产收益率等即期回报指标短期内可能被摊薄。虽然募投项目的实施、补充流动资金的陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此公司的每股收益、净资产收益率等即期回报指标在短期内存在被摊薄的风险。

三、本次发行募集资金的必要性和合理性

本次募投项目经过公司董事会谨慎论证，项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次募投项目的实施，能够进一步提升公司的竞争力，

有利于公司长期可持续发展，具体分析详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司以真空镀膜技术及成膜工艺为核心，长期致力于溅射镀膜技术、蒸发镀膜技术、离子镀膜技术等以及成膜工艺的研究和应用，为客户提供定制化的镀膜装备及工艺解决方案。公司生产的真空镀膜设备应用领域广泛，目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域。

本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入应用于半导体、消费电子、汽车、新能源等领域的PVD设备产能建设项目及补充流动资金，均与公司现有主营业务密切相关，公司将以现有核心技术工艺为基础，升级和优化产品矩阵，完善业务布局，进一步提升核心竞争力，符合国家产业政策导向与公司长期发展战略。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司已充分论证本次募投项目实施的必要性和可行性，在人员、技术、市场等方面做好充足储备，具体详见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析”。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为保护广大投资者的利益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司将采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

（一）强化募集资金管理，保障募集资金使用合法合规

本次发行的募集资金到位后，公司将严格按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定以及公司的《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行专户存储、管理和使用，保障募集资金使用的规范性、安全性、高效性和透明度，同时注重使用资金效益，积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督，降低使用募集资金的风险。

（二）积极稳妥地实施募投项目，提升盈利能力和核心竞争力

本次募投项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策及公司未来整体战略发展方向，并能有效提升公司的核心竞争力，深化半导体、消费电子、汽车、新能源等领域业务布局，为公司带来良好的经济效益。本次募集资金到位前，公司将做好募投项目的前期准备工作。本次募集资金到位后，公司将积极稳妥地实施募投项目，合理安排项目的投资建设进度，尽快实现募投项目效益，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

（四）全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本

公司将完善业务流程，加强对研发、采购、生产、销售各环节的精细化管理，提高公司资产运营效率以及营运资金周转效率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购、费用支出等审批制度，降低成本费用浪费。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，在稳定现有高端人才基础上，引进市场优秀人才，最大限度激发员工积极性。通过以上措施，公司将提升自身运营效率，降低运营成本，从而提升整体经营业绩。

（五）严格执行公司利润分配政策，优化投资者回报机制

根据《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司结合自身实际情况，已制定并披露《广东汇成真空科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。本次发行完成后，公司将严格执行现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极落实对股东的利润分配，促进对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保障投资者的权益。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司相关主体关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，公司实际控制人以及公司董事、高级管理人员等相关主体作出关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的承诺。具体如下：

（一）公司实际控制人对公司填补回报措施的承诺

公司实际控制人罗志明、李志荣、李志方、李秋霞对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

“1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且当前承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照证券监督管理部门的最新规定出具补充承诺；

3、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺

公司全体董事及高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

“1、本人承诺在任何情况下，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、约束本人的职务消费行为，在职务消费过程中本着节约原则行事，不奢侈、不铺张浪费；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定的，且当前承诺不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照证券监督管理部门的最新规定出具补充承诺；

7、本人切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026年8月10日